

产品

PMplast TPA 198 BK 是一种基于成熟高性能共聚多酰胺化学的黑色低压成型树脂。专为热熔胶应用而设计。

PMplast TPA 198 BK 满足电子业的最新要求，例如防水、防尘及化学品防护。

PMplast TPA 198 BK 不含铅，且其配方中不含硅酮或 PAK。同时还满足 ROHs 指令。

热熔胶在热学和介电性能方面具有卓越的性能，而且在环境压力下也可保持这些性能。

应用

汽车、船舶导航和工业设备电子涂层

通过应变消除、弯曲消除及穿壁套管保护连接器和电缆中的电线。

主要性能

- 粘性熔融行为中等
- 被列入 UL 94 V0
- 对大部分表面具有卓越的吸附力
- 低温时也具备良好的柔韧性
- 无需固化
- 符合 ROHS 规范

抵抗恶劣环境

带 PMplast TPA 198 BK 涂料的电子元件能最大限度地抵抗污染物，如灰尘和许多化学品。还能承受腐蚀性气体环境、弱酸、燃料、油、乙二醇及许多汽车和船舶业中使用的其他液体。

涂层可保持优越的附着力，但其持久柔韧性又可承受部件的变形。

加工

PMplast TPA 198 BK 针对自动和半自动应用的大批量生产进行了优化。可用于罐融化和挤压设备。

如果使用了原装密封袋，则可即开即用。如果袋子被打开了，则需进行干燥步骤（60 °C 时最少 4 小时）以减少吸附水含量。建议在使用后再次焊上袋子。

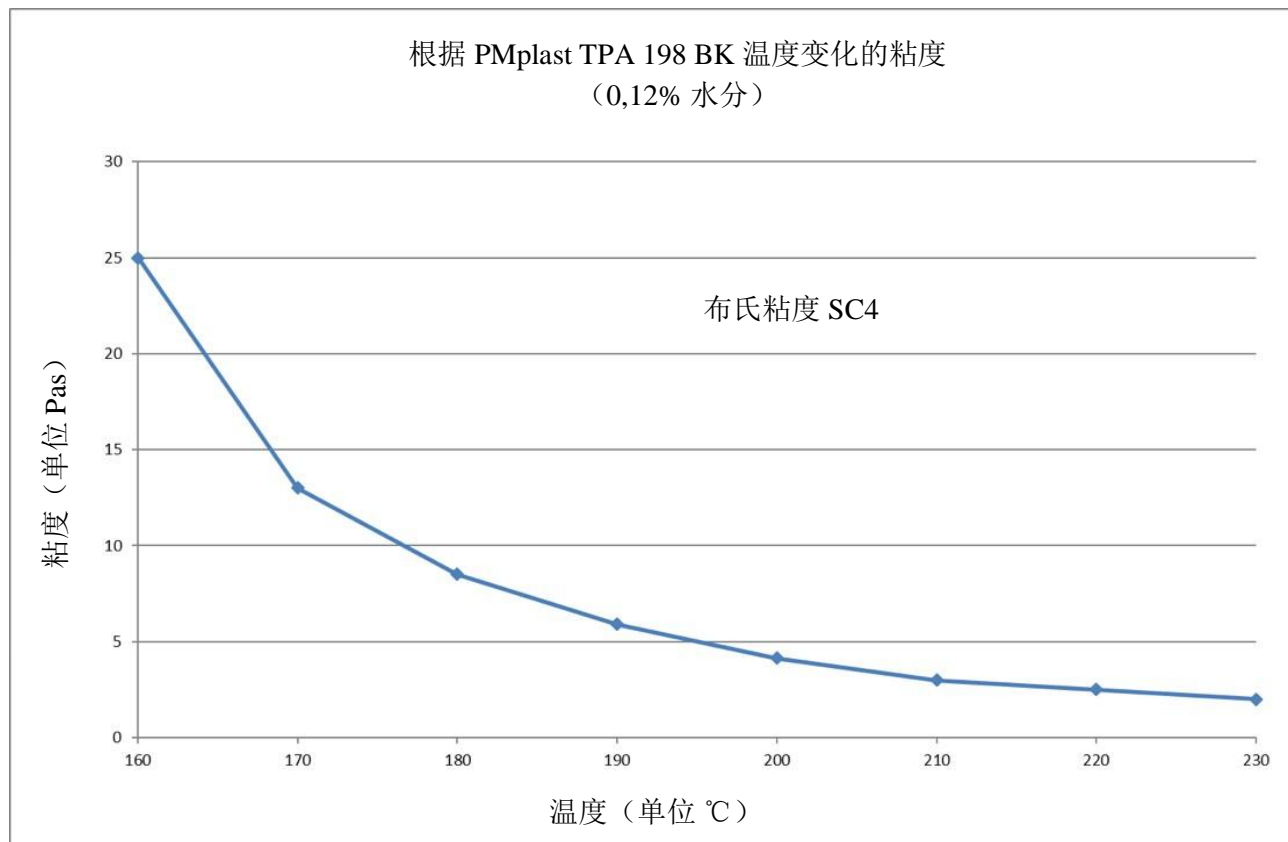
为了借助 PMPLAST TPA 198 BK 实现良好的润湿和无故障附着，确保其与所使用产品的所有部件的兼容性很重要。而且模具的设计也非常重要。

清洗后可优化附着力（例如部件的等离子处理或常规洗涤）。

融化温度范围	190 - 210 °C
成型温度范围	20 - 60 °C
干燥时间，除湿干燥器	4 - 6 小时
干燥温度	60 - 80 °C
加工水分含量	< 0,2%

标准数据

融化，C&B ASTM D3461	157 ± 8 °C
210 °C 时熔体粘度，ASTM D3236	3,0 ± 0,5 Pas
商业形状	粒装
密度，ISO 1183 23 °C	0,98 ± 0,02 g/cm ³
室温下保质期	12 个月
玻璃化温度，DSC 二次运行	-50 °C
硬度 (Shore D)，ISO 868	31
抗张强度，ISO 527-1	> 2,5 MPa
断裂伸长率，ISO 527-1	> 200 %
拉伸模量，ISO 527-2	32 MPa
径迹阻力，IEC 60112	无数据
吸水性，ISO 62，23 °C 24 小时	3,0 %
介电强度，23 °C IEC 60243-1	18 kV/mm
相对介电常数，50Hz，23 °C，IEC 60250	5,7
表面电阻率，IEC 60093，500 V	2,8 x 10 ¹¹ Ohmcm



此数据表中所提供的信息符合我们最新的知识水平与信念，但所提供的信息仅供参考，也适用于任何第三方保护权。您仍然有责任对产品进行检查，了解其是否符合预期的目的和流程。产品的应用、用途和加工超出了我们的合理控制范围，且将完全由您负责。但是如果仍然出现责任在我方的情况，该责任也仅限于对任何由我方交付之产品价值所带来的危害。当然，正如我们的通用条款与条件中所定义的，我们会对产品的无瑕疵品质承担责任。